

Embedded Module

Open Standard Module™ - iesy APL OSM-LE

Technical Concept

- ▶ Platform: Intel® Apollo Lake
- ▶ Arbeitsspeicher: 4GB
- ▶ Abmessung: 45 mm x 45 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-L
Land Grid Array (LGA) mit 662 Kontaktpunkten
- ▶ Spannungsversorgung: 5V über LGA Kontakte
- ▶ Software: Windows 10
- ▶ Temperaturbereich:
 - > Im Betrieb: 0 °C bis +85 °C
 - > Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- ▶ Funktionen & Schnittstellen
 - > 4x USB 2.0
 - > 2x USB 3.0
 - > 3x UART
 - > 8 GPIO
 - > 2x SPI
 - > 2x I2C
 - > 1x I2S
 - > 1x SDIO
 - > 1x JTAG
 - > 4x PWM
 - > 1x Camera Interface
 - > 3x PCI
 - > 1x eDP



Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.



iesy.com/osm